

# 中国通信学会通信专用集成电路委员会 中国半导体行业协会集成电路设计分会

---

## 加速技术创“芯”，驱动智能未来 关于举办“2018 中国集成电路技术应用研讨会 暨南京国际集成电路技术达摩论坛”的通知

伴随着 5G 移动通信、物联网、云计算、人工智能等新技术和新业态的蓬勃发展，全球集成电路产业正迈入新一轮的重大转型和变革期，中国集成电路产业发展面临着新的机遇和挑战。为更好的推动集成电路技术创新，促进我国自主高端核心芯片产业的发展，充分发挥行业学会/协会的桥梁纽带作用，中国通信学会通信专用集成电路委员会、中国半导体行业协会集成电路设计分会拟定于 8 月 22-23 日在南京举办“2018 中国集成电路技术应用研讨会暨南京国际集成电路技术达摩论坛”。会议以“新时代下加速创‘芯’，提升集成电路产业核心竞争力”为主题，邀请院士专家共同探讨“互联网+”、“智能+”时代集成电路技术创新，以及新形势下中国集成电路产业发展机遇与挑战。有关会议事项如下：

### （一）指导单位

中国通信学会

中国半导体行业协会

### （二）主办单位

中国通信学会通信专用集成电路委员会

中国半导体行业协会集成电路设计分会

南京江北新区管委会

### （三）承办单位

南京集成电路产业服务中心（ICisC）

《中国集成电路》杂志社  
上海芯媒会务服务有限公司

**(四) 会议时间**

2018年8月22-23日（8月21日报到）

**(五) 会议地点**

南京明发珍珠泉大酒店

**(六) 会议主题（包括但不限于下述领域）**

1. 5G 移动通信
2. 人工智能
3. 先进存储
4. 车联网
5. 智慧医疗

注：研讨主题包括并不限于以上内容。

**(七) 参会对象**

全国各主要集成电路企业、互联网企业、信息通信企业、智能终端企业、人工智能企业、汽车电子企业以及相关高校、科研院所、新闻媒体等。

**(八) 参会联系**

黄友庚：021-64280295，huangyg@cicmag.com。

赵淑清：zhaoshuqing@datang.com。

请会议承办单位上海芯媒会务服务有限公司认真做好会议各项筹备工作。



2018年4月